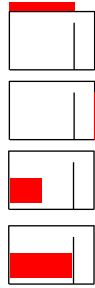


SMT

Advertising formats on www.SMT-Verlag.de

emv-esd

CADS



Type	Size in Pixel	Formats	Price per week
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

You can book any other formats, inclusively videos.
Please don't hesitate to contact our online advertising!

Editorial contact

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
info@smt-verlag.de
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
D-55218 Ingelheim
Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49

Distribution

info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1
D-55218 Ingelheim
Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49

Advertising

Tel: +49 6132 4316-47
Fax: +49 6132 4316-49
E-mail: info@smt-verlag.de

MEDIA INFORMATION 2017

EDITORIAL CALENDAR
CIRCULATION BREAKDOWN
ADVERTISING RATES

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT &
AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG
JAHRGANG 29
NOVEMBER 2016
WWW.SMT-VERLAG.DE
30974

emv-esd 4
electronica 2016

11 **SMT**

RFID ALS BAUSTEIN DER SMART SMT FACTORY

Servicevereinbarungen für planbare Inspektionen Marktübersicht: Leiterplattenhersteller Prüfqualität von EMV-Messungen durch normgerechte Messung an allen Frequenzen

ASM

/// Publisher: Jost Dennier
/// Editor: Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier
Address: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
 Oberer Schenkgarten 1
 D-55218 Ingelheim
 Tel.: +49 61 32 43 16 47
 Fax: +49 61 32 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de
/// Advertising: Telefon: +49 613 2 43 16 47
Address: Fax: +49 61 32 43 16 49
 E-Mail: info@smt-verlag.de
 Web: www.smt-verlag.de
/// Owner: Jost Dennier
/// Verlag: SMT-VERLAG
 Oberer Schenkgarten 1
 D-55218 Ingelheim
/// Volume: 30. Jahrgang 2017
/// Publikation Dates 8 times a year
/// Editorial features: see page 5 and 6
/// Subscription rates: per year: SMT 58,00 Euro incl. Postage
 single copy: 9,00 Euro
 per year: EMV-ESD or CADS 29,00 Euro incl Postage

/// In Brief:

»SMT Germany« with a qualified circulation covers all aspects of electronics manufacturing and testing, with special emphasis on Surface Mount Technology and Advanced Packaging.
 Topics are:
 • Board Assembly
 • Printed Circuit Board Manufacturing
 • Production Techniques in Microelectronics
 • Test and Measurement
 • Market Surveys on the most important products and services
 • Design
 The qualified readers are engineers and technical management involved in the production, assembly, test, QA and inspection of PCBs, who are directly responsible in the specification and purchase of electronic products and services.
EMV-ESD covers all aspects of electromagnetic compatibility (EMC) and the effects of electrostatic discharge (ESD)
CADS serves the computer-aided design industry in electronics and includes topics like verification, routing, signal integrity etc.

/// Printed volume: 9500
/// Current Total circulation : 9244
/// Subscription Circulation: 822
/// Free Samples 8172
/// Rest copies, archives: 250

/// Geographical Breakdown

Area	Copies	%
Germany		
Postal Code 0	218	2,4
Postal Code 1	321	3,5
Postleitzahl 2	521	5,6
Postal Code 3	712	7,7
Postal Code 4	609	6,6
Postal Code 5	712	7,7
Postal Code 6	1141	12,3
Postal Code 7	1971	21,3
Postal Code 8	1626	17,6
Postal Code 9	833	9,0
Foreign Countries		
Switzerland	123	1,3
Austria	117	1,3
UK	89	1,0
Netherlands	90	1,0
Others	161	1,7
Total	9244	100,0

Breakdown by type of business

Classification	Receivers	Copies	%
242	Maschine Tool	621	6,7
243	Data processing/ office machinery	153	1,7
244	Automobile	231	2,5
248	Aeronautics	280	3,0
250	Elektronikmanufacturing	3738	40,4
	Consumer electronics	166	1,8
	Medical electronics	317	3,4
	PCB Manufacturer	238	2,6
	Engineering Offices	1232	13,3
	Test and Measurement	411	4,4
5	Telecommunication / Traffic	825	8,9
	Component Manufacturer	256	2,8
	Power supply	67	0,7
9	Highschools /Education	631	6,8
	others	78	0,8
Total circulation		9244	100,0

Size of companies

Employees	Copies	%
1 bis 9	1375	14,9
10 bis 49	1177	12,7
50 bis 99	812	8,8
100 bis 499	2252	24,4
500 bis 999	829	9,0
1000 and more	2799	30,3
Total	9244	100,0

Job Function

	Copies	%
Commercial Management	614	6,6
Techn. Management	2179	23,6
Research / development	2508	27,1
Konstruktion	708	7,7
Manufacturing	1939	21,0
QA, Test	523	5,7
Purchasing	314	3,4
Sales / Marketing	359	4,3
Student	43	0,5
Universities/others	21	0,2
	9244	100,0

Zeitschriftenformat: DIN A4 210Width x 297 Height mm
Bleed of page 216 Width x 303 Height mm
Satzspiegel: 185 Width x 260 Height mm
Anzeigenformate und Grundpreise: Prices in Euro

Format	Width x Height	Bleed	ads per year	1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303		3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
3/4- Seite	140 x 260 oder 185 x 195	146 x 303		2.900,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	2.200,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303		2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198		2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90		1.450,00	1.250,00	1.150,00	1.100,00	1.050,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303		1.030,00	980,00	920,00	880,00	820,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36		530,00	504,00	474,00	440,00	430,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31			360,00	340,00	324,00	303,00	285,00

special positions: Inside / Outside cover +15%
others +10%

Extra charges for colours:

Format	2-colour	3-colour	4-colour	special colour
1/1 or smaller	390,00	750,00	950,00	600,00
1/2 or smaller	300,00	580,00	750,00	600,00
1/4 or smaller	250,00	450,00	550,00	600,00

Classifies advertising rates

per column, 42 mm Width, millimeter line € 3,00

Bank:

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE83551900000787587013

Payment conditions: within 10 days 2% discount - 20 days net

Bound Inserts:

Paperweight: 80 to 120 g/m²

1 sheet (2 pages)	2 sheet	3 sheet	4 sheet
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

Inserts:

up to 25 g/1000 incl. Porto up to 50 g/1000 incl. Port
270,00 @ 370,00 €

Print: Offset

Electronic files: PDF, TIFF, EPS, JPG, GIF etc.

Address: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
D-55218 Ingelheim, Tel: +49 6132 431647, Fax: +49 6132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Termine	Schwerpunktthemen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Fairs
Ständige Schwerpunkte	Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, -synthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
January/February mit <i>EMV-ESD 1</i> FAIR ISSUE EMV 2017 Editorial Due Date 17.02.2017 Ad Closing Date 24.02.2017 Publication Date 08.03.2017	Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI, Flying Prober Market Survey Connectors		Preliminary Reports EMV 2017 Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	APEX 14. - 16.02.2017 San Diego EMV 28. - 30.03.2017 Stuttgart
March mit <i>CADS 1</i> Editorial Due Date 15.03.2017 Ad Closing Date 22.03.2017 Publication Date 04.04.2017	Preliminary Reports »SMT Hybrid Packaging« Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme Market Survey EMS	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		CeBIT 20. - 24.03.2017 Hannover Hannover Messe 24. - 28.04.2017 Hannover
April/May mit <i>EMV-ESD 2</i> FAIR ISSUE SMT/ HYBRID/ PACKAGING Editorial Due Date 20.04.2017 Ad Closing Date 27.04.2017 Publication Date 04.05.2017	Preliminary Reports »SMT Hybrid Packaging« Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Market Survey Soldering Systems		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Reports EMV 2017 Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	SMT/Hybrid/ Packaging 16. - 18.05.2017 Nürnberg
June/July mit <i>CADS 2</i> Editorial Due Date 12.06.2017 Ad Closing Date 19.06.2017 Publication Date 29.06.2017	Reports »SMT Hybrid Packaging« Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework Market Survey Screen Printing	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		Intersolar Europe 31.05. - 02.06.2017 München
August/September mit <i>EMV-ESD 3</i> Editorial Due Date 17.08.2017 Ad Closing Date 24.08.2017 Publication Date 04.09.2017	Trends in der Bestücktechnik, Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Market Survey Assembly Test Equipment		EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	Motek 09. - 12.10. 2017 Stuttgart
October mit <i>CADS 3</i> Editorial Due Date 13.09.2017 Ad Closing Date 20.09.2017 Publication Date 02.10.2017	Preliminary Reports »productronica« Löttechnik, Selektivlöten Dispensen, Bestückung MCM, Board-Test, ICT, AOI, AXI Market Survey Placement Machines	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		Semicon Europe 14. - 17.10.2017 München parts2clean 24. - 26.10.2017 Stuttgart
November mit <i>EMV-ESD 4</i> Fair Issue »productronica 2017« Editorial Due Date 19.10.2017 Ad Closing Date 26.10.2017 Publication Date 02.11.2017	Preliminary Reports »productronica« Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik Market Survey PCB Manufacturer		Messtechnik Antistatische Materialien Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	productronica 14. - 17.11.2017 München
December mit <i>CADS 4</i> Editorial Due Date 29.11.2017 Ad Closing Date 05.12.2017 Publication Date 14.12.2017	Reports »productronica« Boardhandling, Bonding Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Market Survey Bond Systems	Design, Verifikation, Platzieren, Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		SPS/IPC/DRIVES 28. - 30.11.2017 Nürnberg